

光力科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在董事会的总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度经营目标，积极开展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。

公司 2024 年实现营业收入 57,329.55 万元，其中公司国产化半导体封测装备制造业务营业收入稳步提升；归属于上市公司股东的净利润-11,308.11 万元，同比下滑 263.32%；主要原因为：（1）公司基于谨慎性原则，对商誉、存货、固定资产、合同资产、应收账款等计提减值准备，合计 11,387.15 万元；（2）公司逆势加大了研发投入和市场投入，进一步丰富产品线，以满足客户多样化的市场需求。

半导体封测装备业务方面，一方面受当地国际地域形势紧张和地缘政治影响，ADT 子公司在部分地区业务开展受限，加之运营成本上升导致其收入及利润出现下降，整体经营情况不及预期；公司基于谨慎性原则，全年对半导体业务子公司商誉计提减值准备 9,782.36 万元。但得益于国产半导体设备成熟度及市场认可度不断提升，同时公司紧跟客户的不同工艺发展需求，逆势加大研发投入，成功

推出多种高端机型，为客户提供多样性的产品组合和服务，综合推动国产化设备在手订单保持稳定增长。

物联网安全生产监控业务方面，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会，加大市场推广力度，物联网安全生产监控装备业务保持相对稳定发展态势。

公司 2024 年具体情况如下：

（一）市场营销工作：规模化优势显现，加强双循环的生产营销模式

半导体封测装备业务方面，依托公司在半导体划切领域的技术积累和市场口碑，公司国产化设备进一步扩大现有市场，逐步建立规模化优势，国内半导体业务稳步增长。此外，公司坚持技术、销售、服务三位一体的客户服务模式，构建常态化技术协同网络与市场需求敏捷响应机制，以持续迭代的产品与服务体系赋能客户价值增长；报告期内，公司在 8230 平台基础上，针对汽车电子 Wetable QFN 产品开发的 82WT、8230CF 获得客户订单并得到高度评价。公司持续完善全球化渠道布局，加强国内国外“双循环”推广管理。报告期内，全资子公司光力瑞弘在马来西亚设立子公司，并实现了国产设备在东南亚市场的销售；通过在东南亚市场设立孙公司完善销售渠道，可以加大国际业务的拓展力度，更好的满足海外客户的订单需求，在深化与现有客户合作的同时深入挖掘潜在客户。公司也将充分利用 LP、ADT 的渠道优势和品牌优势，加大在中国、欧美和东南亚的市场推广力度，并进一步优化国内外体系的销售协同合作。通过国内国外双循环的生产营销模式，可以更加灵活的应对国际贸易格局和宏观环境对公司产生的影响，提升自身的综合竞争力和抗风险能力。

物联网安全生产装备业务方面，围绕煤矿智能化建设中的客户痛点和政策要求，持续优化已有产品体系，并通过技术迭代、产品升级、新产品拓展为客户提供更多更优的解决方案。公司为抓住全国智能化矿山建设机遇，大力探索新的销售模式，设立了控股子公司汇力科技、山西智航，为公司物联网业务持续发展奠定基础。

（二）产品研发工作：强化自主创新，逆势加大研发投入，培育可持续增长新动能

公司始终把自主研发创新作为企业成长的核心驱动力，并持续加大研发投入力度。2024 年公司研发投入 11,897.03 万元，研发投入占销售收入的比例为 20.75%，与上年同期相比逆势增长 12.37%。

围绕半导体后道划切磨削领域，公司一方面不断完善产品线布局，逐步丰富封装设备谱系，以满足客户不同应用环节的需求；另一方面，公司紧跟客户关键工艺创新带来的划切需求，加大新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级，以进一步提升公司满足客户需求的能力和公司的产品竞争力。公司基于 8230 平台技术成功开发出针对客户特殊应用的高价值机型，如针对汽车电子 Wetable Flanks QFN 产品开发的 8230CF、82WT，针对 CIS 产品及光学产品开发的 8230CIS；公司研发的应用于晶圆 DBG 半切的 8231，延续了 8230 高效率、高精度、高性能、高可靠性的特征，可实现基于产品表面的精确切深控制，已于 2025 年 SEMICON CHINA 展出。半导体激光划片机 9130 和切割分选一体机 7260 也已进入验证阶段；晶圆减薄抛光一体机 3330，目前正在按计划研制中，该设备采用三轴四工作台配置，可以在同一工作台上实现从晶片背面研磨到干式抛光加工，并且具有实现高稳定性薄化加工的能力。

在物联网安全监测领域，公司依托在煤矿安全监测领域的技术积累和产品优势，不断丰富产品体系，并拓宽产品的应用范围。报告期内，公司针对采空区火源定位难问题，采用透地通信火灾定位技术研发了采空区火源定位系统，可以准确定位采空区的发火位置；针对易燃易爆等危、化、毒气体泄漏的监测，采用红外高光谱成像技术开发了气云光谱视频监测预警系统，具有非接触测量、监测覆盖范围广、实时性高等特点；针对传统电化学一氧化碳传感器标定周期长、易受环境干扰的情况，开发了激光一氧化碳传感器，具有稳定可靠、使用方便的特点；针对瓦斯回收利用过程中大断面瓦斯精准计量和风量计量难问题研发了分布式管道瓦斯气体综合参数测定仪，具有集成化程度高、测量精度高、稳定性好、抗干扰性强、标校周期长等特点，也可用于贸易结算。

凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务，公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度，公司市场竞争力不断提升。此外，公司持续提升产品品质和快速响应客户需求的能力，并与客户建立了良好合作关系，客户的广泛认可以及新产品的不断推出为公司业务的快速拓展奠定坚实基础。

（三）生产制造工作：聚焦生产协同，提升产品质量管控

报告期内，公司聚焦生产协同、工艺优化、材料降本、损耗改善等方面工作，不断提升公司产品质量管控，提高公司产品竞争力和经营效益。公司航空港区新厂区投产后已具备良好的生产能力，生产效率不断提升，规模化生产效应进一步显现；为对冲局部地域冲突对以色列子公司 ADT 生产经营的影响，航空港区可以为 ADT 子公司提供生产协同和采购支持，同时还可以将以色列 ADT 工厂部分型号设备在郑州工厂生产，以满足相关客户的订单需求。充分发挥英国工厂的区位优势，从过去定制化产品开始转型为批量化产品为主、定制化产品为辅的模式，并拓宽公司量产产品在欧洲等国际市场的销售，目前英国工厂已经完成了转产设备的产品认证。

（四）核心零部件布局：加强核心零部件的研发应用及市场拓展

公司高度重视核心零部件的安全自主可靠，LP 生产研发的各种高性能静压气浮主轴已在以色列、日本及欧洲在内的数十家客户实现销售。

在半导体业务领域，公司生产研发的零部件有切割主轴、磨削主轴、抛光主轴、晶圆/光学检测主轴、气浮转台、空气导轨、DD 马达、驱动器等。报告期内，公司围绕空气主轴精密制造技术，不断丰富国产零部件种类，实现了空气导轨、旋转工作台、高速电机和驱动器等核心零部件的国产替代；目前国产核心零部件已经应用到部分国产化划切设备中并实现销售。公司也将在保证设备性能和稳定性的前提下，逐步提升国产零部件的比例。公司核心零部件的国产化不仅可以保证国产设备供应链的安全自主可控，也能通过规模化生产降低设备成本，并提升公司设备满足客户定制化需求的能力。

在非半导体业务领域，公司生产研发的核心零部件有汽车喷漆主轴、光学镜片磨削主轴、金刚石磨削主轴、磨削铣削主轴、一体式反向式行星滚柱丝杠电动缸等，产品性能处于业界领先地位，特别是在电子工业中的切割、汽车工业的喷漆、接触式透镜行业的金刚石车削等领域，有着广泛的应用和客户认可度。围绕空气主轴的精密制造技术，公司也将不断对核心零部件产品进行迭代升级，以高度适配不同行业客户的实际需求。

（五）数字化赋能：加快数字化转型，推动企业高质量发展

公司积极推动数字化转型规划落地，以“信息化、数字化、智能化、可视化”为方向，加强研发管理信息化系统建设、优化供应链系统管理以实现从业务运营到经营管理的全面数字化管理，推动多板块、多业务的互联互通、协同共享，实现“降本、增效、提质”。同时，数字化技术还能帮助公司精确控制生产成本，通过数据分析找出生产过程中的浪费环节，并采取有效措施加以改进，从而降低生产成本，提高盈利能力。

（六）人力资源工作：持续加强对研发、工程技术人员和生产技术人员的培养

技术与产品研发的核心动力是人才，公司高度重视人才梯队的建设，采取多种措施加强对研发和工程技术人才培养和发展，同时公司加大对一线生产技术人员的工作，培养和储备一定数量的熟练工程师和技师，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开了十三次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024年2月6日	第五届董事会第七次会议	逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 2、回购股份符合相关条件 3、回购股份的方式、价格区间 4、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例 5、回购股份的资金来源 6、回购股份的实施期限 7、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
2	2024年2月8日	第五届董事会第八次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
3	2024年3月29日	第五届董事会第九次会议	《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

			<p>告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司其他高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》</p> <p>《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
4	2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第十次会议	《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
5	2024 年 8 月 28 日	第五届董事会第十一次会议	<p>《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于〈公司 2024 年总经理半年度工作报告〉的议案》</p> <p>《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于计提商誉减值准备的议案》</p>
6	2024 年 8 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
7	2024 年 9 月 23 日	第五届董事会第十三次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
8	2024 年 10 月 23 日	第五届董事会第十四次会议	《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
9	2024 年 10 月 25 日	第五届董事会第十五次会议	《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
10	2024 年 11 月 13 日	第五届董事会第十六次会议	<p>《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》</p>
11	2024 年 11 月 22 日	第五届董事会第十七次会议	《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》
12	2024 年 12 月 12 日	第五届董事会第十八次会议	<p>《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
13	2024 年 12 月 30 日	第五届董事会第十九次会议	<p>《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》
3	2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已按时执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 5 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 2 次会议，审议通过了公司董事 2024 年度薪酬情况、其他高级管理人员 2024 年度薪酬情况、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期激励对象 2023 年度个人业绩完成情况的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2025 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司持续稳定健康发展。

4、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事专门会议严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关制度并召开专门会议。在 2024 年度工作中，公司独立董事审慎、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，根据相关规定独立董事专门会议对需要审议的议案进行认真审议。报告期内共召开 6 次会议，充分发挥了独立董事及独立董事专门会议的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2024 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、2025 年度公司的经营计划

公司聚焦半导体封测装备领域和物联网安全生产装备领域，致力于成为“植根中国、掌握核心技术的全球领先半导体装备和工业智能化装备研发制造企业”。2025 年，公司将坚定不移的围绕战略目标，把握半导体设备国产替代和行业复苏的发展机遇以及煤矿智能化建设的市场契机，一方面持续加大技术创新的投入

力度，不断丰富产品线，以更好的产品和服务满足客户需求；另一方面，强化内部运营管理，提升整体运营效率，实现营收规模的持续增长和利润水平的稳步提升，为客户及股东创造更大的价值。

2025年，公司将坚持自主研发的发展战略，以客户需求为中心、以研发创新为驱动，以管理增效为支撑，从市场营销、产品研发、生产制造、人才建设等多维度协同发力，持续强化公司竞争优势，巩固和提升市场占有率，助力公司实现长期高质量的发展。

2025年具体经营计划如下：

（一）市场营销工作：优化全球营销体系，提升产品市占率

半导体封测装备业务方面，公司将紧跟行业发展趋势和市场需求变化，加大对国内外头部封测企业、重点封测企业的推广力度，做好重点客户服务和目标客户开发及导入工作，确保2025年销售目标的完成。公司将进一步完善全球市场营销体系，不断完善海外销售渠道布局；通过国内国外双循环的生产营销模式，更好地满足目标客户的订单需求，增强客户粘性；充分利用LP、ADT的渠道优势和品牌优势，加大在中国、欧美和东南亚的市场推广力度，并进一步完善优化国内外体系的销售协同合作。加大国产化刀片的销售力度，加快国产化硬刀等新产品的验证进度；加大核心零部件的市场推广力度，拓宽核心零部件应用场景；公司将继续坚持技术、销售、服务三位一体的客户服务模式，进一步提升快速响应客户需求和现场服务的能力，持续提高公司产品的市场占有率和品牌影响力。

物联网安全生产装备业务方面，结合智能矿山的产业发展趋势以及安全生产、减员增效的总体趋势，在现有产品体系基础上不断开发新产品和新应用满足客户的相关需求，继续巩固公司的市场优势和品牌优势。加快瓦斯单孔计量、采空区火情定位系统、气云光谱视频监控预警系统、激光一氧化碳传感器、分布式管道瓦斯气体综合参数测定仪等新产品的推广力度，扩大公司的收入和利润规模。

公司将持续加强与客户端的沟通互动，通过展会、行业论坛、新品发布会、技术交流会等多元化方式，及线上研讨会、社交媒体互动等数字化方式丰富沟通渠道，积极拓展与客户的交流空间；在深化与现有客户合作的同时积极开拓新客户，提升产品市占率；加快产品验证进度，提高市场响应速度，提升服务质量，

增强客户认同感，进而提升公司品牌知名度和市场影响力。同时，公司也将严格筛选招投标项目，提升订单质量；继续加大应收账款回款力度，提升公司财务健康状况。

（二）产品研发工作：初步完成机械切割、激光切割、研抛设备布局

公司始终坚持自主创新的发展路径，持续跟踪客户需求变化，不断丰富产品线，推动产品的升级迭代和新产品、新工艺的开发，以期为客户提供更优质的产品和服务。公司将利用国内外公司共享技术平台，充分发挥国内团队与英国、以色列研发系统整体的协同效应，提升研发效率；持续推进半导体切磨抛设备、核心零部件和耗材的国产化进程，保障公司供货安全稳定，也为国内供应链安全保驾护航。

2025 年，公司在半导体业务领域将初步完成切磨抛产品线的布局；在机械划片机方面，公司开发的用于基板切割的 JIG SAW 7260、用于 DBG 工艺且更加智能的 8231 将推向市场；在激光划片机方面，公司研发的用于半导体 Low-K 开槽的激光划片机 9130、用于超薄晶圆切割的隐形切割激光划片机 9320 预计推向市场；其中，9320 可以用于 SiC、GaN 等脆性材料的切割以及 MEMS 等抗负荷能力差工件的切割；在研抛领域，公司用于超薄晶圆磨削的研磨抛光一体机 3330 也正在研发过程中。公司将持续拓宽产品品类，丰富产品系列，为客户提供更全面更具竞争力的半导体封装产品，占领更多的细分市场，为公司的长期可持续发展奠定基础。

（三）生产制造工作：强化精益生产和生产协同

公司持续开展精益生产和降本增效工作，优化产线制度管理、人员编排及布局调整，推动生产流程的精细化与高效化，以提升公司生产质量管理能力。精细把控生产经营各环节，从源头杜绝质量瑕疵，力求产品与服务达到甚至超越最高质量标准，以卓越质量赢得客户信赖与市场认可，公司也将积极推进生产信息化系统的升级，借助数据化分析及时发现并解决潜在质量问题，提升产线的智能化管理水平，为公司长远发展奠定坚实基础。

航空港区厂区生产管理能力的优化不仅可以提高公司国产化设备的生产能力，使公司更有能力满足国内目标客户日益增长的需求，还可以为 ADT 子公司提

供生产协同和采购支持，提升以色列工厂的生产弹性，有效降低因国际地缘冲突带来的潜在风险。半导体装备、关键零部件以及耗材等生产能力的逐步提升，将使公司规模效应进一步显现，从而提升企业综合竞争力。

（四）可转债项目建设：全力推进空气主轴等核心零部件的国产化产能建设

公司为适应市场需求和国际形势的变化，在可转债项目原设计基础上，优化了建设方案；根据目前情况，可转债项目预计于 2027 年 5 月底完工。公司全力推进项目建设，预计建设完成后可大幅提升公司核心零部件的生产制造能力。公司将以可转债募投项目为契机，全力推进空气主轴等核心零部件的国产化产能建设。加快半导体设备和核心零部件产能提升进度，满足市场增长的需求，巩固和扩大市场份额。

（五）AI 赋能：积极引入和应用 AI 技术及大模型

在公司产品研发及运维中，积极引入和应用 AI 技术及大模型，具体体现在：

（1）优化内部流程，推动流程自动化，提高部门之间的合作效率，降低人力成本；（2）结合市场需求及公司核心技术和产品，提升公司产品数智化水平，提升产品综合竞争力；如在物联网安全生产监控领域，通过大模型与瓦斯抽采、人员定位、应急监控、火灾监控、AI 视频分析等系统的深度融合，利用集成大模型的动态学习、分析、辅助决策等能力，经过深入的算法创新与应用开发，将显著提升公司系统类产品的智能化水平，为客户提供更优质的服务，助力客户矿山智能化建设。

（六）人力资源工作：持续强化人才体系建设

优秀人才是持续保持公司创新能力和竞争实力的核心要素。为增强竞争优势，进一步巩固公司的行业领先地位，公司将不断完善人才培育机制、优化人才培养环境、营造良好的人才发展生态，充分发挥员工的创造力和潜在动力，以人才优势推动技术创新和业务发展，为实现公司的战略目标提供强大的智力支持和人才保障。

2025 年，光力科技将以“无业可守、创新图强”的经营理念为指引，在董事会的战略部署下，以技术创新为核心，以市场开拓为导向，凝聚国内外团队的

力量，全面落实战略举措，努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日